2024-2030年中国铜箔行业市场竞争策略及发展趋 向分析报告

报告大纲

智研咨询 www.chyxx.com

一、报告简介

智研咨询发布的《2024-2030年中国铜箔行业市场竞争策略及发展趋向分析报告》涵盖行业最新数据,市场热点,政策规划,竞争情报,市场前景预测,投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址: https://www.chyxx.com/research/202012/919865.html

报告价格: 电子版: 9800元 纸介版: 9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明:本PDF目录为计算机程序生成,格式美观性可能有欠缺;实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

为方便行业人士或投资者更进一步了解铜箔行业现状与前景,智研咨询特推出《2024-2030年中国铜箔行业市场竞争策略及发展趋向分析报告》(以下简称《报告》)。报告对中国铜箔市场做出全面梳理和深入分析,是智研咨询多年连续追踪、实地走访、调研和分析成果的呈现。

为确保铜箔行业数据精准性以及内容的可参考价值,智研咨询研究团队通过上市公司年报、 厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作,并对数据进行多维度分析, 以求深度剖析行业各个领域,使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解2022年铜箔行 业的发展态势,以及创新前沿热点,进而赋能铜箔从业者抢跑转型赛道。

铜箔是由铜或铜合金通过轧制或电解等工艺制成的一种阴质性电解材料。铜箔是制作印制电路板(PCB)、覆铜板(CCL)和锂离子电池不可缺少的主要原材料。根据加工工艺的不同,铜箔可分为电解铜箔和压延铜箔两大类。其中电解铜箔是利用电化学原理通过铜电解而制成的,制成生箔的内部组织结构为垂直针状结晶构造,其生产成本相对较低。压延铜箔是利用塑性加工原理,通过对铜锭的反复轧制-

退火工艺而成的,其内部组织结构为片状结晶组织,压延铜箔产品的延展性较好。

随着近年来我国电子信息技术的不断发展,我国PCB产量不断增长,同时,在"双碳"目标的战略驱动下,包括新能源汽车、可再生能源发电及储能在内的新能源产业受到国家的大力支持,新能源汽车、风力发电、光伏、储能等领域随之迅速发展,锂离子电池需求量猛增,并由此带动了动力电池及其负极集流材料铜箔的需求量快速增长,成为推动我国铜箔行业的发展强劲动力。据资料显示,2022年我国铜箔行业产能约为111.66万吨,同比增长53%;产量为80万吨,同比增长23.2%;销量约为79.69万吨,同比增长23.5%。从产量结构方面来看,在锂电池需求量快速增长的推动下,2022年我国锂电铜箔产量大幅增长,一举超过电子电路铜箔成为产量占比最大的细分种类,2022年占比为51.9%,而电子电路铜箔产量占比为46.3%,压延铜箔产量占比为1.9%。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司成立于2010年,公司主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售等,主要产品按应用领域分类包括PCB铜箔和锂电池铜箔。公司是国内电子铜箔行业领军企业之一,拥有电子铜箔产品总产能为4.5万吨/年,其中,PCB铜箔产能2.5万吨/年,锂电池铜箔产能2万吨/年,形成了"PCB铜箔+锂电池铜箔"双核驱动的业务发展模式,是我国铜箔行业重点上市企业之一。据资料显示,2022年公司铜箔业务营收为35.32亿元,同比下降5.51%。其中PCB铜箔业务占比为59.2%,锂电池铜箔业务占比为40.8%。

工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019版)》将极薄铜箔列为先进有色金属

材料,将锂电池超薄型高性能电解铜箔列为新型能源材料,即电子铜箔为国家重点发展战略方向。从电子铜箔下游应用领域来看,电子信息产业及新能源汽车行业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业,国家亦出台多项政策促进上述产业发展。国家政策的扶持将为电子铜箔产业提供广阔的发展空间,助力铜箔制造业全面转型升级,国内铜箔生产制造行业将借此契机不断提升企业竞争力。

以发展新一代信息网络,拓展5G应用,建设数据中心为代表新型基础设施建设系我国推动产业升级的重点发展方向。5G基站及数据中心建设是高速率网络通信的基础设施,对于打造数字经济时代发展新动能、引导新一轮科技产业革命并构筑国际竞争优势,具有重要的战略意义。5G基站/IDC建设需要高频高速PCB基板技术提供支持。高频高速电子铜箔作为高频高速PCB基板的关键材料之一,在产业升级过程中需求增长明显,成为行业发展方向。拥有低粗糙度的RTF铜箔和HVLP铜箔生产工艺的高新技术企业,将受益于产业升级的趋势得到较快发展。

《2024-2030年中国铜箔行业市场竞争策略及发展趋向分析报告》是智研咨询重要成果,是智研咨询引领行业变革、寄情行业、践行使命的有力体现,更是铜箔领域从业者把脉行业不可或缺的重要工具。智研咨询已经形成一套完整、立体的智库体系,多年来服务政府、企业、金融机构等,提供科技、咨询、教育、生态、资本等服务。

报告目录:

- 第一章 2019-2023年世界铜箔产业运行态势分析
- 第一节 2019-2023年世界铜箔产业运行环境综述
- 第二节 2019-2023年世界铜箔业运行概况
- 一、世界电解铜箔业发展与演进
- 二、世界铜箔生产工艺研究
- 三、国外PCB用铜箔技术新发展
- 四、全球压延铜箔市场动态分析
- 第三节 2019-2023年世界主要铜箔生产国家运行分析
- 一、美国
- 二、日本
- 三、韩国

第四节 2024-2030年世界铜箔市场发展趋势分析

第二章 2019-2023年世界压延铜箔重点企业运行浅析第一节 NIPPON MINING(日本)

第二节 福田金属FUKUDA(日本)

第三节 MITSUI MINING AND SMELTING CO. (日本)

第四节 FURUKAWA ELECTRIC (日本)

第三章 2019-2023年中国铜箔市场运行环境解析

第一节 2019-2023年中国铜箔市场经济环境分析

- 一、中国GDP分析
- 二、消费价格指数分析
- 三、城乡居民收入分析
- 四、社会消费品零售总额
- 五、全社会固定资产投资分析
- 六、进出口总额及增长率分析

第二节 2019-2023年中国铜箔市场政策环境分析

第三节 2019-2023年中国铜箔市场技术环境分析

第四章 2019-2023年中国铜箔市场发展现状综述

第一节 2019-2023年中国铜箔业发展动态

第二节 2019-2023年中国铜箔技术水平分析

第三节 2019-2023年中国铜箔业发展中存在的问题

第五章 2019-2023年中国铜箔市场运营情况分析

第一节 2019-2023年中国铜箔业市场运行分析

第二节 2019-2023年中国铜箔市场运营动态分析

第六章 2019-2023年中国铜箔制造所属行业规模以上企业经济运行数据监测

第一节 2019-2023年中国铜箔制造所属行业数据监测回顾

- 一、竞争企业数量
- 二、亏损面情况
- 三、市场销售额增长
- 四、利润总额增长
- **万、投资资产增长性**
- 六、行业从业人数调查分析

第二节 2019-2023年中国铜箔制造所属行业投资价值测算

- 一、销售利润率
- 二、销售毛利率

- 三、资产利润率
- 四、2024-2030年铜箔制造所属行业盈利能力预测
- 第三节 2019-2023年中国铜箔制造所属行业产销率调查
- 一、工业总产值
- 二、工业销售产值
- 三、产销率调查
- 四、2024-2030年铜箔制造所属行业产销预测
- 第四节 2019-2023年铜箔制造出口交货值数据
- 一、出口交货值增长
- 二、出口交货值占工业产值的比重

第七章 2019-2023年中国铜箔行业进出口贸易数据统计分析

第一节 2019-2023年中国铜箔行业进出口数据监测分析

- 一、2019-2023年中国铜箔进口数据分析
- 二、2019-2023年中国铜箔出口数据分析
- 三、2019-2023年中国铜箔进出口平均单价分析
- 四、2019-2023年中国铜箔进出口贸易方式分析
- 第二节 2019-2023年中国铜箔行业进出口主要市场数据监测分析
- 一、2019-2023年中国铜箔进口主要市场分析
- 二、2019-2023年中国铜箔出口主要市场分析
- 三、2019-2023年中国铜箔进口主要市场平均单价分析
- 四、2019-2023年中国铜箔出口主要市场平均单价分析
- 第三节 2019-2023年中国铜箔行业进出口主要地区数据监测分析
- 一、2019-2023年中国铜箔进口主要地区分析
- 二、2019-2023年中国铜箔出口主要地区分析
- 三、2019-2023年中国铜箔进口主要地区平均单价分析
- 四、2019-2023年中国铜箔出口主要地区平均单价分析

第八章 中国铜箔行业市场竞争格局

第一节 中国铜箔行业竞争格局

- 一、行业企业竞争格局
- 二、行业技术竞争格局
- 三、行业区域竞争格局
- 第二节 中国铜箔行业竞争力分析
- 一、上游议价能力分析

- 二、下游议价能力分析
- 三、行业内企业竞争分析
- 四、替代品威胁分析
- 五、潜在进入者分析
- 六、行业市场竞争总结
- 第三节 中国铜箔行业集中度分析

第九章 中国铜箔行业内优势企业竞争力及关键性数据分析

- 第一节 诺德投资股份有限公司
- 一、企业简介
- 二、企业经营状况
- 三、企业竞争力分析
- 四、企业发展战略
- 第二节 九江德福科技股份有限公司
- 一、企业简介
- 二、企业经营状况
- 三、企业竞争力分析
- 四、企业发展战略
- 第三节 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
- 一、企业简介
- 二、企业经营状况
- 三、企业竞争力分析
- 四、企业发展战略
- 第四节 广东超华科技股份有限公司
- 一、企业简介
- 二、企业经营状况
- 三、企业竞争力分析
- 四、企业发展战略
- 第五节 山东金宝电子股份有限公司
- 一、企业简介
- 二、企业经营状况
- 三、企业竞争力分析
- 四、企业发展战略
- 第六节 惠州合正电子科技有限公司
- 一、企业简介

- 二、企业经营状况
- 三、企业竞争力分析
- 四、企业发展战略

第十章 2019-2023年中国PCB行业发展状况分析

第一节 2019-2023年中国印刷电路板行业的总体概况

第二节 2019-2023年我国印刷电路板市场发展现状分析

- 一、印刷电路板市场生产结构分析
- 二、印刷电路板市场需求特点分析
- 三、印刷电路板市场技术发展分析

第三节 2019-2023年我国印刷电路板行业发展存在的主要问题分析 第四节 2019-2023年中国印刷电路行业发展对策分析

第十一章 2024-2030年中国铜箔市场投资战略研究

第一节 2019-2023年中国铜箔投资环境分析

- 一、中国铜矿资源产业投资政策解读
- 二、中国宏观经济环境分析

第二节 2024-2030年中国铜箔市场投资机会分析

- 一、铜箔行业成为新的投资热点
- 二、铜箔细分产品投资机会分析
- 三、铜箔产业相关政策调整投资机会分析

第三节 2024-2030年中国铜箔市场投资风险预警

- 一、宏观调控政策风险
- 二、市场竞争风险
- 三、原料供给风险
- 四、市场运营机制风险

第四节 投资建议

第十二章 2024-2030年中国铜箔市场发展趋势与前景展望

第一节 2024-2030年中国铜箔市场发展前景展望

- 一、电子级铜箔尤其是高性能市场看好
- 二、铜箔产品前景光明
- 三、中国电解铜箔市场前景趋好

第二节 2024-2030年中国铜箔产业发展趋势前瞻

一、电解铜箔业的发展趋势

二、铜箔业技术发展趋势

第三节 2024-2030年中国铜箔市场走势预测

- 一、铜箔供需预测分析
- 二、铜箔价格走势预测
- 三、铜箔进出口贸易预测分析

第四节 2024-2030年中国铜箔业市场盈利能力预测分析

图表目录:部分

图表1:2019-2023年全球铜箔市场规模走势

图表2:电解铜箔分类情况

图表3:2019-2023年全球电解铜箔市场规模

图表4:2019-2023年全球压延铜箔市场规模走势

图表5:主要产业政策

图表6:2019-2023年中国铜箔行业专利数量趋势图(单位:件)

图表7:2019-2023年中国铜箔产能情况

图表8:2019-2023年中国铜箔细分产品产能情况

图表9:2019-2023年中国铜箔产量情况

图表10:2019-2023年中国铜箔细分产品产量情况

图表11:2019-2023年中国铜箔生产统计表

图表12:2019-2023年国内企业铜箔销售情况

图表13:2019-2023年中国铜箔进口整体情况

图表14:2019-2023年中国铜箔出口整体情况

图表15:2023年中国压延铜箔行业主要企业业绩情况

图表16:2023年中国电解铜箔行业主要企业业绩情况

图表17:2023年中国电解铜箔行业集中度分析

图表18:2023年中国压延铜箔行业集中度分析

图表19:2024-2030年中国铜箔供需预测

图表20:2024-2030年中国铜箔价格预测

图表21:2024-2030年中国铜箔市场规模预测

更多图表见正文......

详细请访问: https://www.chyxx.com/research/202012/919865.html